中華民國專利證書

發明第　I641804　號

發 明 名 稱：樓板厚度量測方法

專 利 權 人：內政部建築研究所

發　明　人：蔡銘儒、王天志、詹家旺、邱英倫

專利權期間：自2018年11月21日至2038年 6 月 3 日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局 局長　洪淑敏

中華民國 107 年 11 月 21 日

注意：專利權人未依法繳納年費者，其專利權自原繳費期限屆滿後消滅。

南一國際智慧財產權事務所
107.11.22
收發文

檔　　號：B、
保存年限：
10780-4

經濟部智慧財產局　函

機關地址：臺北市大安區辛亥路2段185號3樓
傳　　真：(02)23779875

708　　掛號
臺南市安平區建平五街122號
受 文 者：內政部建築研究所（代理人：陳豐裕　專利代理人）

發文日期：中華民國107年11月21日
發文文號：（107）智專一（一）證字第10772752390號
1077275239001
速　　別：
密等及解密條件：
附件：專利證書1紙

裝

主旨：發給第107119185號專利案發明I 641804號專利證書1紙，自民國117年起，每年應於11月20日屆期前繼續繳納年費，請查照。

訂

說明：

一、依107年10月11日所繳證書費及第1至第10年年費辦理。

二、有關本局年費繳納通知僅屬提醒性質，非本局法定義務，嗣後每年年費，不待本局通知，務請依限自行繳納，以維護台端（貴公司）之權益。

線

正本：內政部建築研究所
（代理人：陳豐裕　專利代理人）

局長 洪淑敏

依照分層負責規定
授權單位主管決行

【19】中華民國　　【12】專利公報　（B）

【11】證書號數：I641804
【45】公告日：中華民國 107 (2018) 年 11 月 21 日
【51】Int. Cl.：　*G01B21/08　(2006.01)*

發明　　全 4 頁

【54】名　稱：樓板厚度量測方法
FLOOR THICKNESS MEASUREMENT METHOD

【21】申請案號：107119185　　【22】申請日：中華民國 107 (2018) 年 06 月 04 日

【72】發 明 人：蔡銘儒 (TW) TSAI, MING JU；王天志 (TW) WANG, TIEN CHIH；詹家旺 (TW) CHAN, CHIA WANG；邱英倫 (TW) CHIU, YING LUN

【71】申 請 人：內政部建築研究所　ARCHITECTURE AND BUILDING RESEARCH INSTITUTE, MINISTRY OF THE INTERIOR
新北市新店區北新路三段 200 號 13 樓

【74】代 理 人：陳豐裕

【56】參考文獻：

TW	M342499	CN	103604409A
CN	206891331U	CN	206974363U

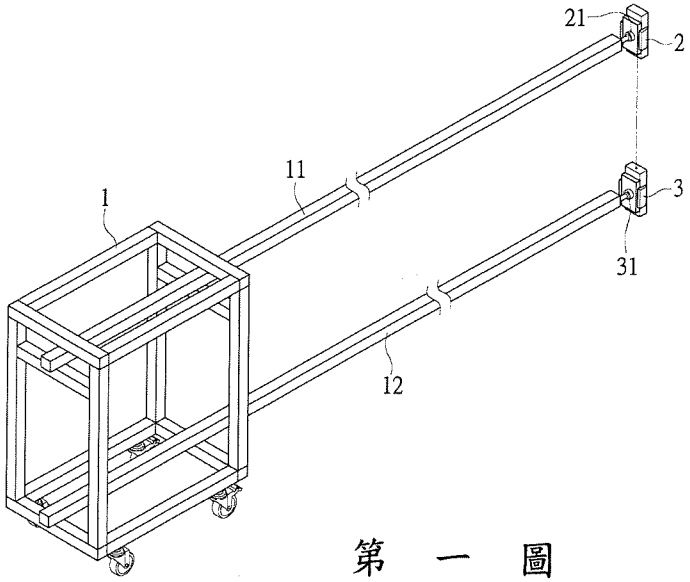
審查人員：邱元玠

【57】申請專利範圍

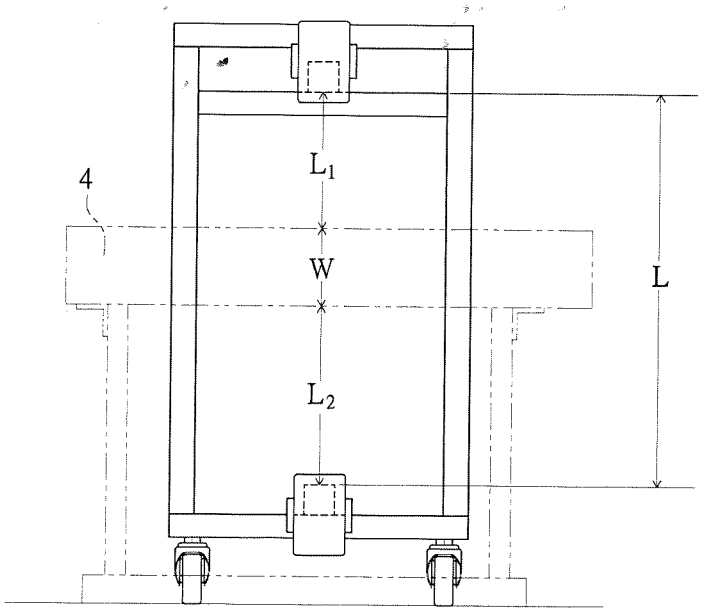
1. 一種樓板厚度量測方法，其主要係分別開啟上部測距儀與下部測距儀，調整該上部測距儀之位置及該下部測距儀之位置，令該上部測距儀與該下部測距儀之測距訊號相對應對齊，將該上部測距儀與該下部測距儀同時移動至基準板處，使得該上部測距儀之測距訊號與該下部測距儀之測距訊號分別偵測於該基準板同一垂直線上的頂部與底部位置處，令控制裝置讀取所連接之該上部測距儀之偵測距離 L_1，且該控制裝置讀取所連接之該下部測距儀之偵測距離 L_2，並利用量尺測得該基準板之厚度W，即可求得總長度 $L = L_1 + L_2 + W$，再將該基準板更換為待測樓板，令該上部測距儀之測距訊號與該下部測距儀之測距訊號分別偵測於該待測樓板同一垂直線上的頂部與底部位置處，令該控制裝置讀取該上部測距儀所偵測與該待測樓板之間的距離 L_3，且該控制裝置讀取該下部測距儀所偵測與該待測樓板之間的距離 L_4，最後將 $L-(L_3+L_4)$ 即可得到該待測樓板之厚度。
2. 如申請專利範圍第 1 項所述樓板厚度量測方法，其中，該上部測距儀連接設有上部萬向接頭供調整該上部測距儀之位置。
3. 如申請專利範圍第 1 項所述樓板厚度量測方法，其中，該下部測距儀連接設有下部萬向接頭供調整該下部測距儀之位置。

圖式簡單說明

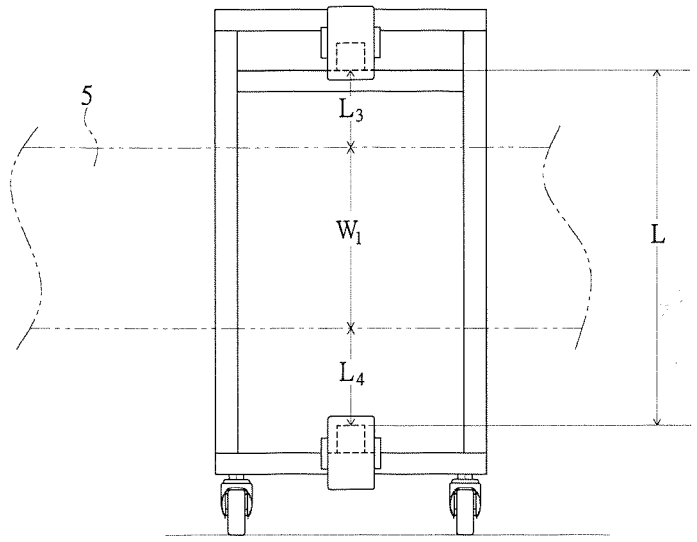
第一圖：本發明之立體結構示意圖
第二圖：本發明之基準板量測狀態示意圖
第三圖：本發明之待測樓板量測狀態示意圖
第四圖：本發明之待測樓板量測狀態側視示意圖
第五圖：本發明之待測樓板量測狀態局部放大立體示意圖



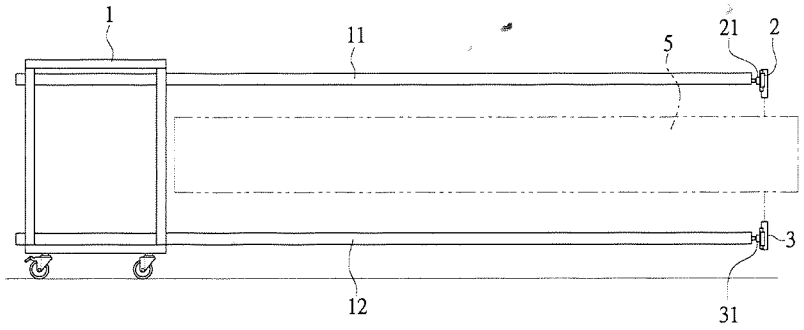
第 一 圖



第 二 圖



第 三 圖



第 四 圖